

主催：応用物理学会微小光学研究会

協賛：京都工芸繊維大学, 日本光学会, オプトロニクス社



第177回微小光学研究会 「表示技術とイメージングの新展開」

表示技術とイメージングは、高次の観測・可視化、そしてスマート社会の実空間と仮想空間をつなぐ重要な基盤技術です。これらの技術は、物理・材料・デバイスなど多様な分野の融合を通じて、高機能化と応用の新たな展開を実現しています。本研究会では、次世代を拓く表示技術とイメージングの両面の視点から、物理、材料、デバイス、システムといった各技術層における最先端の動向を取り上げます。本分野の第一線の研究者による講演を通じて、表示技術とイメージングの現状を概観し、将来の技術を展望する機会とします。

日時： 2025年12月22日(月)13:00-17:10

会場： 京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス 60周年記念館
1F 記念ホール（オンライン同時開催予定）

〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町

https://www.kit.ac.jp/uni_index/access/

交通： 京都市営地下鉄烏丸線「松ヶ崎」駅より徒歩8分。

<JR・近鉄>「京都」駅から地下鉄烏丸線

「国際会館」行きに乗換、「松ヶ崎」駅まで約18分。



プログラム

13:00-13:10 開会の挨拶

13:10-13:40 みんなに届く大空からのメッセージドローン×レーザー投影ー 石野正人(大阪大)

13:40-14:10 メタサーフェスホログラフィによるフルカラー動画投影 岩見健太郎(東京農工大)

14:10-14:40 体積映像を実世界へ：レーザー励起による発光と光散乱 熊谷幸汰(宇都宮大)

14:40-15:00 <休憩>

15:00-15:30 符号化開口を用いたレンズレスイメージング 中村友哉(大阪大)

15:30-16:00 小型で高画質な広視野カメラの実現に向けた湾曲 CMOS イメージセンサ
後藤正英(NHK 技研)

16:00-16:30 マルチメガピクセル 3次元積層電荷収集型 SPAD イメージセンサ
岩田旬史(キヤノン)

16:30-17:00 強度輸送方程式を用いた高速物体の非干渉 3次元イメージング 栗辻安浩(京都工繊大)

17:00-17:10 閉会の挨拶

参加費(消費税込、予稿集代含む)： 応用物理学会会員 4,000 円、非会員 5,000 円

学生・シニアの応用物理学会会員 1,000 円、学生・シニアの非会員 2,000 円

参加申込： 要事前申込。 <https://www.comemoc.com/> よりお申込ください。

(開催日の数日前に予稿集と請求書を郵送いたしますので、参加費を後日お支払いください。)

担当委員： 河野(三菱電機), 國分(ものづくり大), 佐藤(NTT), 濱口(九州大), 宮本(東京科学大), 裏(京都工繊大)

問合せ先： office■comemoc.com (■を@に換えてください)

微小光学研究会 代表：伊賀健一 運営委員長：波多腰玄一 実行委員長：宮本智之

副代表：中島啓幾 運営副委員長：横森清

※プログラムは微小光学研究会のウェブサイト <https://www.comemoc.com/> でもご覧いただけます。

※オンライン同時開催予定です。現地会場における聴講は先着順のため、会場の定員(100名)に達する場合はオンライン聴講となりますのでご了承ください。